



開発品

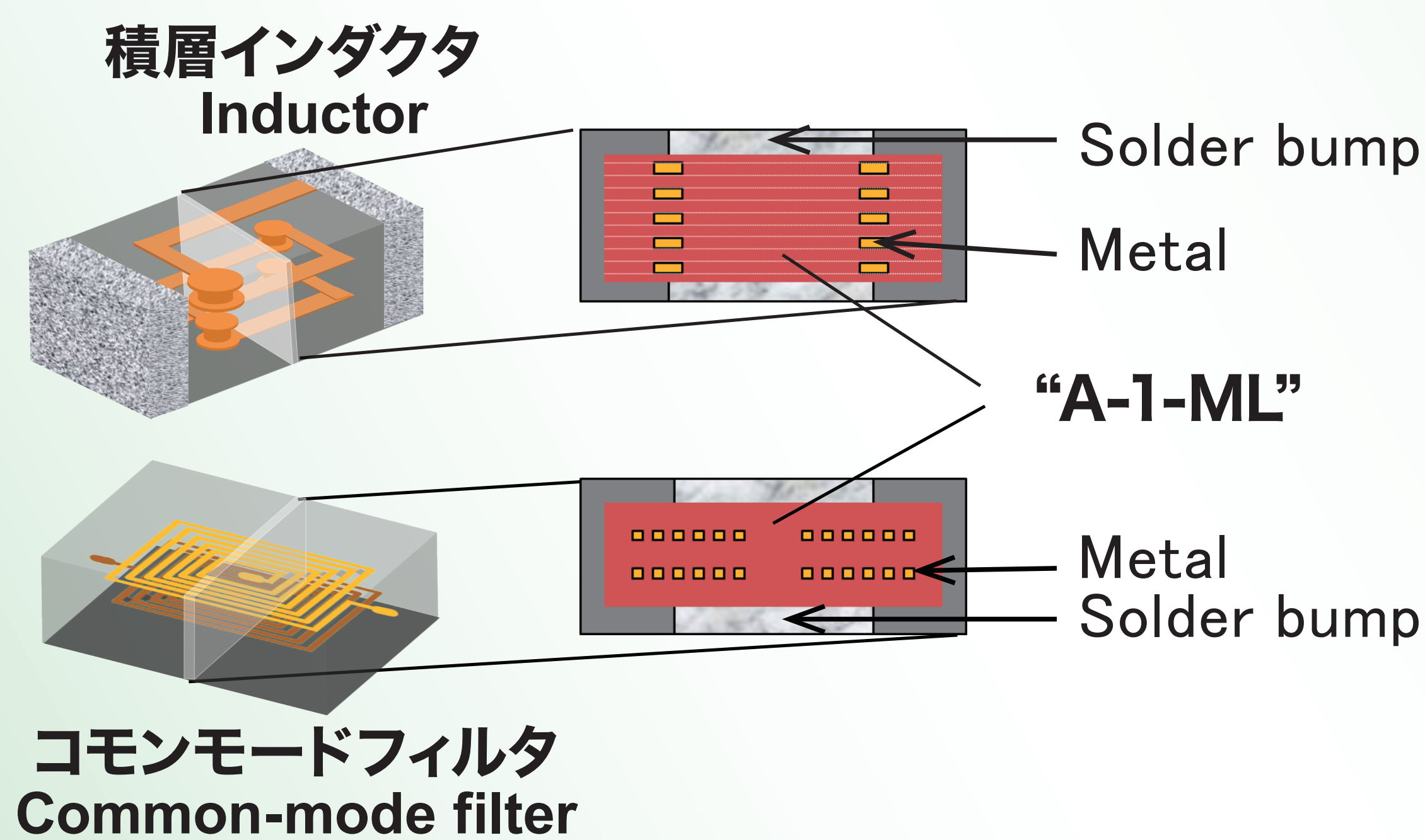
感光性層間絶縁材料”A-1-ML“

Photosensitive Dielectric Interlayer Materials for Passive Components

特長 Features

- **速硬性 Rapid Hardening**
短い硬化時間で優れた機械物性を有しています。 A-1-ML shows a good mechanical properties in a short period of curing.
- **優れた薬品耐性 Highly Chemical Resistance**
200 um以上の積層が可能です。 A-1-ML has a good chemical resistance for lamination.

用途例 Application



特性 Film Properties

| Item | unit | A-1-ML | | |
|-----------------------|---------------------|--------|-------|-------|
| Cure temperature | °C | 320 | 320 | |
| Curing Time | min. | 10 | 60 | |
| Thermal properties | Tg(TMA) | °C | 240 | 260 |
| | CTE(50-200°C) | ppm/°C | 53 | 53 |
| | 5% weight loss temp | °C | 389 | 405 |
| Mechanical properties | Tensile strength | MPa | 108 | 108 |
| | Young's modulus | GPa | 2.7 | 2.7 |
| | Elongation | % | 42 | 53 |
| Dielectric properties | Dk(10GHz) | - | 2.8 | 2.8 |
| | Df(10GHz) | - | 0.012 | 0.009 |

開発品

炭酸ナトリウム現像型感光性絶縁材料

1%Na₂CO₃aq. Developable Photosensitive Insulating Materials

特長 Features

- **低温硬化性 Lower Curing Temperature**
240°C以下の低い硬化温度で優れた熱機械物性を有しています。 ≤240°C cured film shows a good thermal and mechanical properties.
- **高解像度 High Resolution**
アスペクト1以上の高い解像度を有しています。 Can form fine pattern with aspect ratio above 1.

用途例 Application

- **ビルドアップ基板 Build-up Board**
- **多層FPC Multilayer FPC**
- **受動部品 Passive Components**
- **2.1D・2.5D インターポーザ 2.1D・2.5D Interposer**

特性 Film Properties

| Item | unit | New Product | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|--------|
| Cure temperature | °C | 240 | |
| Curing Time | min. | 60 | |
| Thermal properties | Tg(TMA) | °C | 260 |
| | CTE(50-200°C) | ppm/°C | 45 |
| | Tensile strength | MPa | 105 |
| Mechanical properties | Young's modulus | GPa | 2.7 |
| | Elongation | % | 60 |
| | Dielectric properties | Dk(10GHz) | - |
| Df(10GHz) | | - | 0.0057 |



TAIYO INK MFG. CO., LTD.